

Chemicals contained in products

Package-type

Epson Package name; **QFP8-128PIN-E1**

JEITA Package name; **P-QFP128-2828-0.80**

Terminal plating; **Lead(Pb) Free**

Weight; **5.77 [g]※1**

Part	Subpart	Subpart weight [mg]	Substance name	CAS No.	Content ※2		Application
					[mg]	[ppm]	
チップ	ICチップ	164	シリコン	7440-21-3	164	999894	主成分
			ホウ素	7440-42-8	0.0003	2	ドーパント
			無機リン	7723-14-0	0.0008	5	ドーパント
			アルミニウム	7429-90-5	0.003	20	配線材
			ヒ素 ※3	7440-38-2	0.0008	5	ドーパント
			フッ素 ※3	7782-41-4	0.0003	2	ドーパント
			チタン ※3	7440-32-6	0.003	20	配線材
			モリブデン ※3	7439-98-7	0.003	20	配線材
			タングステン ※3	7440-33-7	0.005	30	配線材
			コバルト ※3	7440-48-4	0.0003	2	配線材
	保護膜	3.3	ポリイミド	-	3.3	1000000	保護膜 ※4
パッケージ	ダイアタッチ材	5.0	銀	7440-22-4	3.4	682731	主成分
			エポキシ樹脂	-	1.0	200803	接着剤
			フェノール樹脂	-	0.38	76305	接着剤
			無機粉末	-	0.20	40161	添加物
	端子メッキ	47	錫	7440-31-5	46	980350	鉛フリーはんだ
			ビスマス	7440-69-9	0.92	19650	鉛フリーはんだ
	リードフレーム	808	銅	7440-50-8	764	944933	導体材
			銀	7440-22-4	4.1	5074	インナーリードメッキ
			その他成分 ※5	-	40	49994	添加剤
	ボンディングワイヤー	5.9	金	7440-57-5	5.9	1000000	導体材
	モールド樹脂	4736	エポキシ樹脂	-	237	50004	主成分
			三酸化アンチモン	1309-64-4	19	4012	難燃助剤
			ブロム化エポキシ樹脂	-	43	8996	樹脂難燃剤
			シリカ	60676-86-0/-	3821	806952	充填材
			カーボンブラック	1333-86-4	71	15014	樹脂着色剤
			硬化剤(フェノール樹脂等)	-	284	60014	硬化剤
			有機リン化合物	-	24	5005	硬化促進剤
その他			-	237	50004	添加剤	

化学物質の情報について

- ※1 パッケージの重量は、内蔵するチップのサイズ等、個別のIC仕様により多少異なる場合があります。
- ※2 含有データは、製品への意図的添加及び各サプライヤーからの情報に基づき算出された値であり、保証値ではありません。従って、実測値はこのデータと多少異なる場合があります。
- ※3 これらの物質は、内蔵するICチップの仕様により、含有する場合としない場合があります。
- ※4 個別の機種により保護膜を使用しない場合があります。
- ※5 Cuタイプの場合は、ニッケル、亜鉛、錫、ケイ素、鉄、酸化亜鉛が、42alloyタイプの場合は、炭素、ケイ素、マンガンが含まれます。